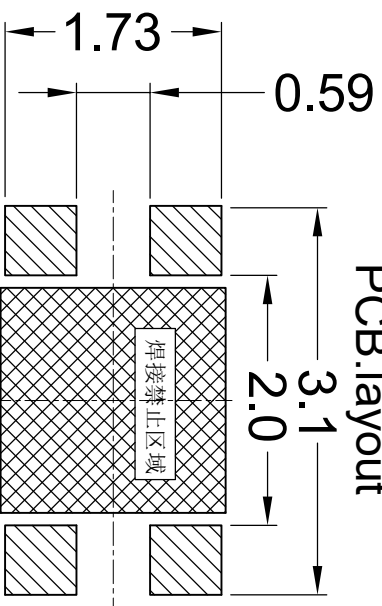
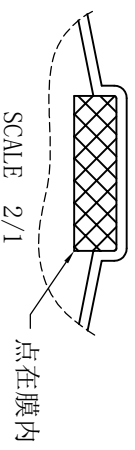
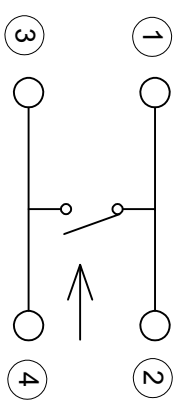
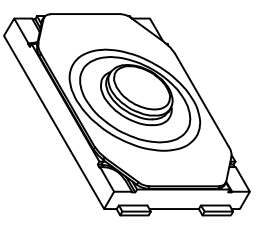


Circuit Diagram



丝网厚度为0.1mm
相对于焊盘，开口率为60~100%。
(推荐80%)

PCB layout



焊锡涂布量波动有可能导致安装焊接不良，
因此请使用推荐焊盘和丝网。

- ▨: 推荐焊盘区域
- ▩: 焊接禁止区域
- ▧: 部分请不要设置焊盘或导线

如设置焊盘或志线时，为避免金属部分露出，请进行绝缘涂层处理。
金属部分露出的话，通过焊锡球有可能和开关背面的端子发生短路。
并且，由于铜箔的厚度、焊盘的布局等不同，产生凹凸的段差，有可能会对开关斜、与焊锡的接合状态、助焊剂侵入等问题产生影响。
因此，使用前请进行事前验证。

主要技术指标: Main Specifications

气候等级 Climate grade	额定值 Rated values	接触电阻 Contact resistance	耐压 Dielectric strength	绝缘电阻 Insulation resistance	按压力 Operating force	行程 Travel	寿命 Life
-30℃~+85℃	Max50 mA12V DC Min10 mA1V DC	≤100mΩ	100V AC, 1Min	≥100mΩ	2.2 N	0.13±0.1	1000000次

序号	名称	数量	材料	备注
5	端子	1	C5191	镀银
4	胶点	1	聚酰亚胺	黑色
3	黄膜	1	聚酰亚胺	白色(透明)
2	弹片	2	SUS301-Ag0.5	单面镀银
1	塑胶底座	1	PA6T RG430	黑色

单位:MM	类型:	型号:	图幅: A4	第一页 共一页
	轻触开关	TAF02-BWN-R	线性公差: ±0.1	角度公差: ±1.5°
设计:	why		比例: 1:1	投影视角: 3
审核:	why			
批准:				